

デジタル試験業界で唯一の無半田垂直基板マウントを採用した、モレックスの革新的、精密コンプレッションマウントマイクロテストコネクタは、設計の最適化の柔軟性および取り付け時間の短縮を実現し、最大65 GHzで20 Gbps以上のアナログ信号性能を達成した製品です。

特徴・利点

1.85mmバージョン 65 GHzアナログ信号	20 Gbps以上の高速デジタル試験基板の為に広帯域性能を実現する、市場で唯一の65 GHz帯コンプレッションマウントコネクタ
2.92mmバージョン 40 GHzアナログ信号	1.85および2.4mmバージョンより、関連アクセサリ、終端器、アダプターと併せて低コストの代替品として使用可能
0-80 UNFネジ2本を使用した特殊なコンプレッションマウント設計	半田工程をなくし、取り付け時間を短縮。基板厚は0.57mm~2.79mm、それ以外にも要求に応じてオプション対応。コネクタと基板間を継続的にグランド接続
嵌合寸法:1.85mm、2.4mm、2.92mm	ネットワークアナライザケーブルとの互換性有り
垂直マウント設計	はんだ付けコネクタと比較して、より多くの試験用コネクタをテスト対象デバイス (DUT) 周囲に設置可能なためケーブル配線密度が高い。基板上のどこにでも設置可能なため、テストを柔軟に運用可能
内蔵センターピン設計	基板にマウント後のインターフェース寸法を最適化。反射を低下させ、精密測定に貢献
耐久性に優れたステンレス製ハウジング	挿抜回数500回以上

精密コンプレッションマウントマイクロテストコネクタ

73157 1.85mm 垂直コンプレッションマウント

73387 2.4mm 垂直コンプレッションマウント

73252 2.92mm 垂直コンプレッションマウント



精密コンプレッションマウントマイクロテストコネクタ

仕様

特徴・概要

梱包形態: トレー
 嵌合相手: 1.85mm、2.4mm、2.92mm
 オス型プラグ
 (試験装置のケーブル端に対応)
 寸法単位: mm
 RoHS準拠: 準拠
 ハロゲンフリー: 準拠

機械的性能

嵌合力 (最大): .23N
 耐久挿抜回数: 500回

電気的性能

接触抵抗:
 センターコンタクト — <3 mΩ
 アウターコンタクト — <2 mΩ
 耐電圧: 500V RMS
 絶縁抵抗: 5,000 MΩ以上
 VSWR (最大):
 DC~26.5 GHz — 1.10
 26.5~40 GHz — 1.20
 40~50 GHz — 1.30
 (2.4mmおよび1.85mmバージョンのみ)
 RFリーク: <-100dB
 RF挿入損失 (最大):
 0.03 x √f (GHz) dB

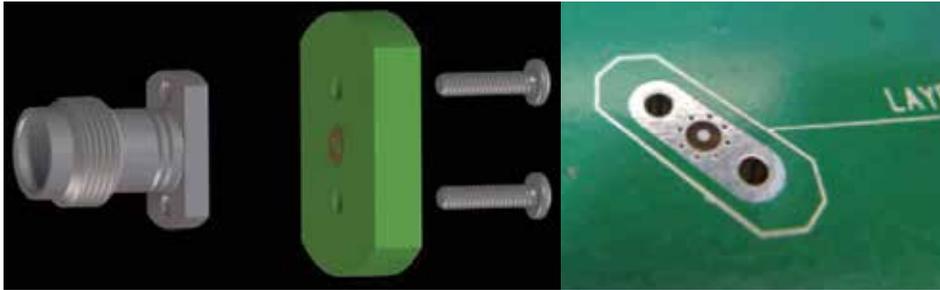
精密コンプレッション マウントマイクロテスト コネクタ

材質

ハウジング: ステンレス鋼
 コンタクト: ベリリウム銅
 メッキ:
 センターコンタクト — 金 (Au)
 下地メッキ — ニッケル (Ni)
 基板厚:
 0.57~2.79mm (標準)
 その他要求に応じてオプション対応
 使用温度範囲: 0~+165 °C

その他の製品の特徴

- 基板へのレセプタクルの取り付けに0-80 UNFネジ2本を使用し、半田付けを不要にした革新的なデザイン。



取り付け方法 (0-80 UNFネジを2本使用し、レセプタクルを基板に取り付ける。ハンダ不要)

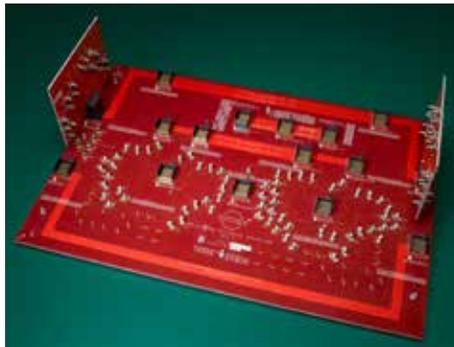
コネクタを取り付ける実際のパッド

アプリケーション

データ通信およびテレコミュニケーション
 アプリケーション

- 試験および特性評価ボード
- リファレンスバックプレーン
- 高速バックプレーン

試験および測定用機器チップメーカー



リファレンスバックプレーン

オーダーインフォメーション

オーダー番号	インターフェースタイプ	取り付けネジ長さ
73157-0000	1.85mm	なし
73157-0001		4.76mm
73157-0002		6.35mm
73387-0020	2.4mm	4.76mm
73387-0021		6.35mm
73387-0022		なし
73252-0090	2.92mm	4.76mm
73252-0091		6.35mm
73252-0092		なし